

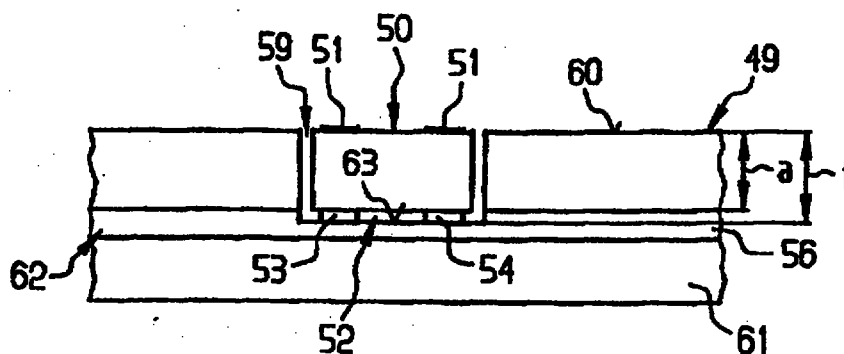


PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: G06K	A2	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/35273 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 25. September 1997 (25.09.97)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE97/00538 (22) Internationales Anmeldedatum: 17. März 1997 (17.03.97) (30) Prioritätsdaten: 196 10 098.4 ✓ 15. März 1996 (15.03.96) DE 196 10 507.2 ✓ 18. März 1996 (18.03.96) DE (71)(72) Anmelder und Erfinder: FINN David [IE/DE]; König-Ludwig-Weg 24, D-87459 Pfronten (DE); RIETZLER, Manfred [DE/DE]; Am Alsterberg 10, D-87616 Marktoberdorf (DE). (74) Anwalt: TAPPE, Hartmut; Jaeger, Böck & Köster, Egloffsteinstrasse 7, D-97072 Würzburg (DE).	(81) Bestimmungsstaaten: AU, CA, CN, JP, KR, (SG), US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i>	

(54) Title: **CHIP CARD** ✓

(54) Bezeichnung: **CHIPKARTE**



(57) Abstract

The disclosure relates to a chip card for contact or contact-free access to a chip inside a chip module. The chip module is arranged in a recess (59) in a card body (49) in such a way that outer contact surfaces (51) of the chip module are disposed on the surface (60) of the card body (49) and inner contact surfaces (53) of the chip module are connected to the wire ends (55, 56) of a coil (57) fitted in the card body to form a transponder unit. The coil is a wire-wound coil (57) and the recess (59) for the chip module is of a depth (t) such that wire ends (55, 56) inside the recess (59) are provided with a flattened contact area (63) by the process which forms the recess (59).

3

(57) Zusammenfassung

Chipkarte für kontaktbehafteten und kontaktlosen Zugriff auf einen in einem Chipmodul angeordneten Chip, wobei das Chipmodul derart in einer Ausnehmung (59) eines Kartenkörpers (49) angeordnet ist, daß äußere Kontaktflächen (51) des Chipmoduls an der Oberfläche (60) des Kartenkörpers (49) angeordnet sind und innere Kontaktflächen (53) des Chipmoduls zur Ausbildung einer Transpondereinheit mit Leiterenden (55, 56) einer im Kartenkörper angeordneten Spule (57) verbunden sind, wobei die Spule als Drahtspule (57) ausgebildet ist und die Ausnehmung (59) zur Aufnahme des Chipmoduls in ihrer Tiefe (t) so bemessen ist, daß im Bereich der Ausnehmung (59) angeordnete Drahtenden (55, 56) eine durch den Bearbeitungsvorgang zur Herstellung der Ausnehmung (59) gebildete Kontaktabflachung (63) aufweisen.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauritanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						